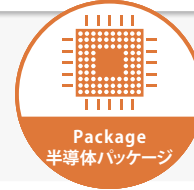


High heat resistance Secondary mounting Sidefill/ Underfill materials 高耐熱性二次実装サイドフィル・アンダーフィル材



Applications 用途

Mount reinforcement of semiconductor packages and electronic parts for Automotive camera modules, Millimeter-wave radar modules, ECU
半導体パッケージや電子部品の実装補強、車載カメラモジュール、ミリ波レーダモジュール、車載 ECU



Achieving the necessary mount reliability for automotive quality by industry's highest heat resistance and low CTE. "Corner reinforce type" also be available. Compliant with RoHS.

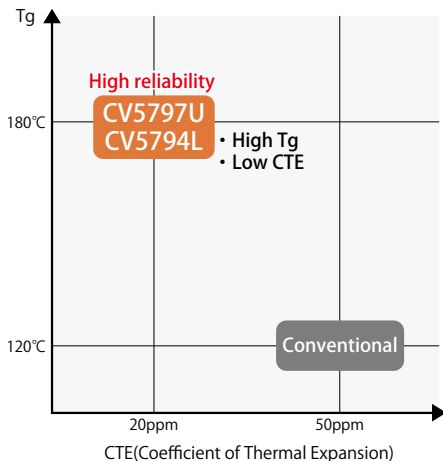
業界最高のガラス転移温度と低熱膨張係数を両立し、車載品質の実装信頼性を実現。「コーナー補強タイプ」もラインアップ。RoHS 対応。

Industry's highest
Tg 160°C
業界最高のガラス転移温度

Compatible with the PKG size
of 25 mm square or more
25mm角以上のPKGに対応可能

Pot life is long 3 days
ロングポットライフ 3日間

Concept コンセプト



Reinforcement type (Applicable IC PKG) 補強タイプ (適応半導体パッケージ)

Sidefill

- For large-size PKG (e.g. 25 mm square or more)

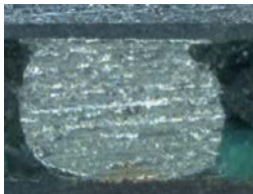
Underfill

- For small and medium size PKG (e.g. 20 mm square or less)

Correspond to temperature cycle test under Automotive environment 車載環境下での温度サイクル試験に対応

CV5797U CV5794L

Conventional



Item	CV5797U	Conventional
Temperature cycling test (TCT) -55°C ⇄ 125°C 30min	6000 cycles Pass	3000 cycles Pass

General Properties 一般特性

Item	Unit	CV5797 series Sidefill (Corner glue)	CV5794 series Underfill
Glass transition temp.(Tg)	°C	160	160
C.T.E.1	ppm/°C	14	21
Elastic modulus (25°C)	GPa	18	15
Storage condition	—	-20°C/ 6months	

The above data are typical values and not guaranteed values. 上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。